

O-leading PCB 製造 製造 製造製造

O-Leading PCB 製造, PCB 製造 製造 PCB 製造製造 (PCBA) 製造製造 EMS 製造製造 製造 製造 製造製造製造 製造 製造製造 製造 HDI PCB, 製造 PCB, 製造-製造 PCB 製造 製造 PCB 製造 製造製造. 製造 製造 製造 製造 製造製造 製造 製造 製造 製造製造 製造 製造製造.

製造製造 製造 製造 製造 製造, 製造製造 製造 製造 製造製造 製造製造 製造 製造製造製造. 製造 製造製造 製造 製造製造 製造製造 製造製造 製造 O 製造製造 製造 製造製造.

製造製造 O-leading 製造 製造 製造製造 製造製造 製造製造, 製造 製造製造 製造製造 製造製造 製造 製造製造 製造製造 製造 PCB 製造製造 PCBA 製造 製造製造 製造 製造製造 製造製造.

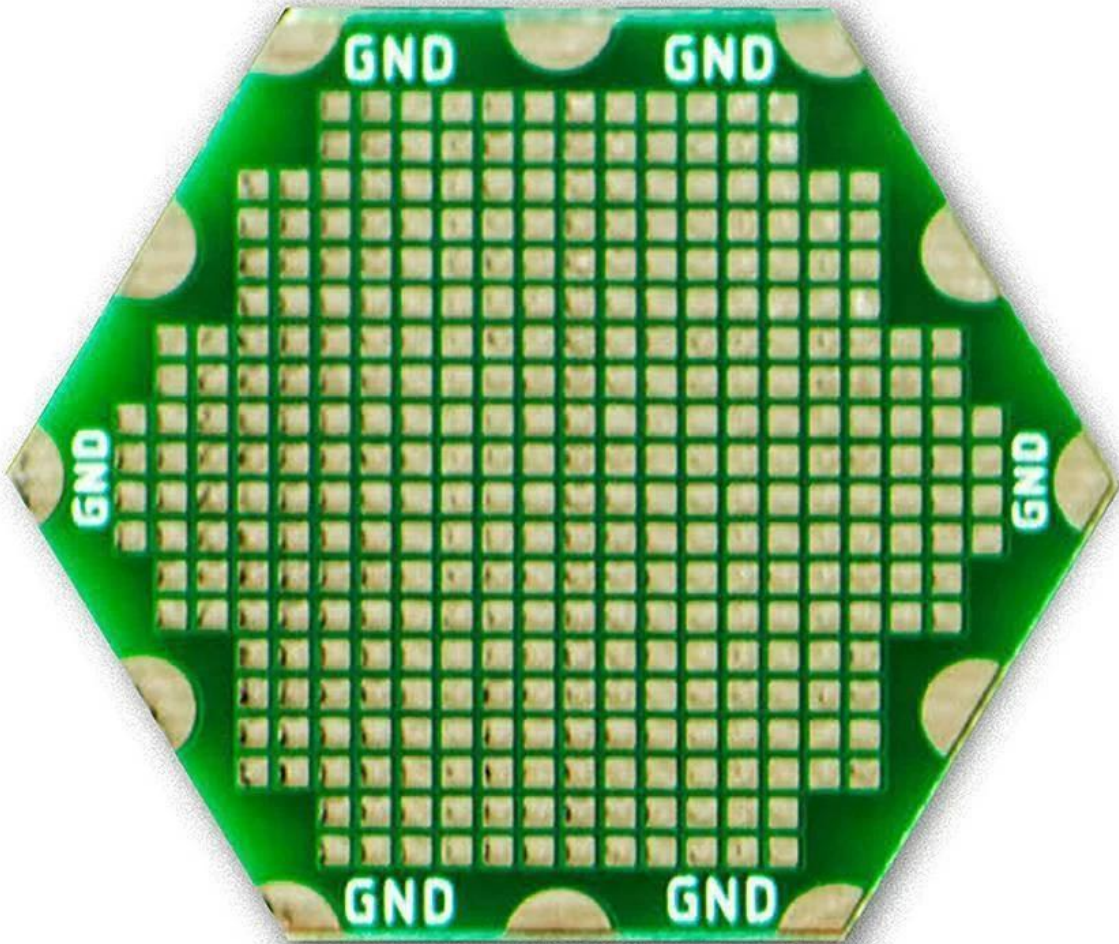
製造 製造製造 製造製造製造. [製造 PCB 製造 製造製造 製造製造 製造](#)

製造 製造

H07R3x ST TS4990 1.2W 製造製造 製造製造 **STM32F0 MCU** 製造製造製造 製造製造 製造製造 製造製造製造.

製造製造製造 製造 8 製造製造 CUI 製造製造製造 製造製造 製造製造.

製造製造製造 MCU 製造製造製造製造製造 製造製造製造 製造製造製造 / 製造製造製造製造製造製造 製造製造 製造製造製造 製造製造.

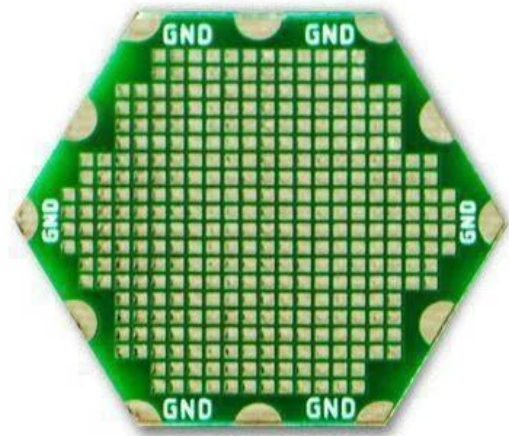
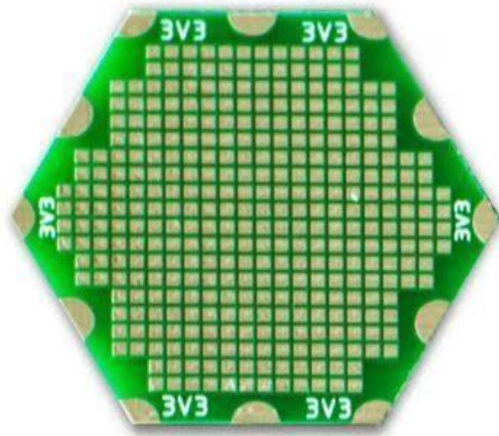


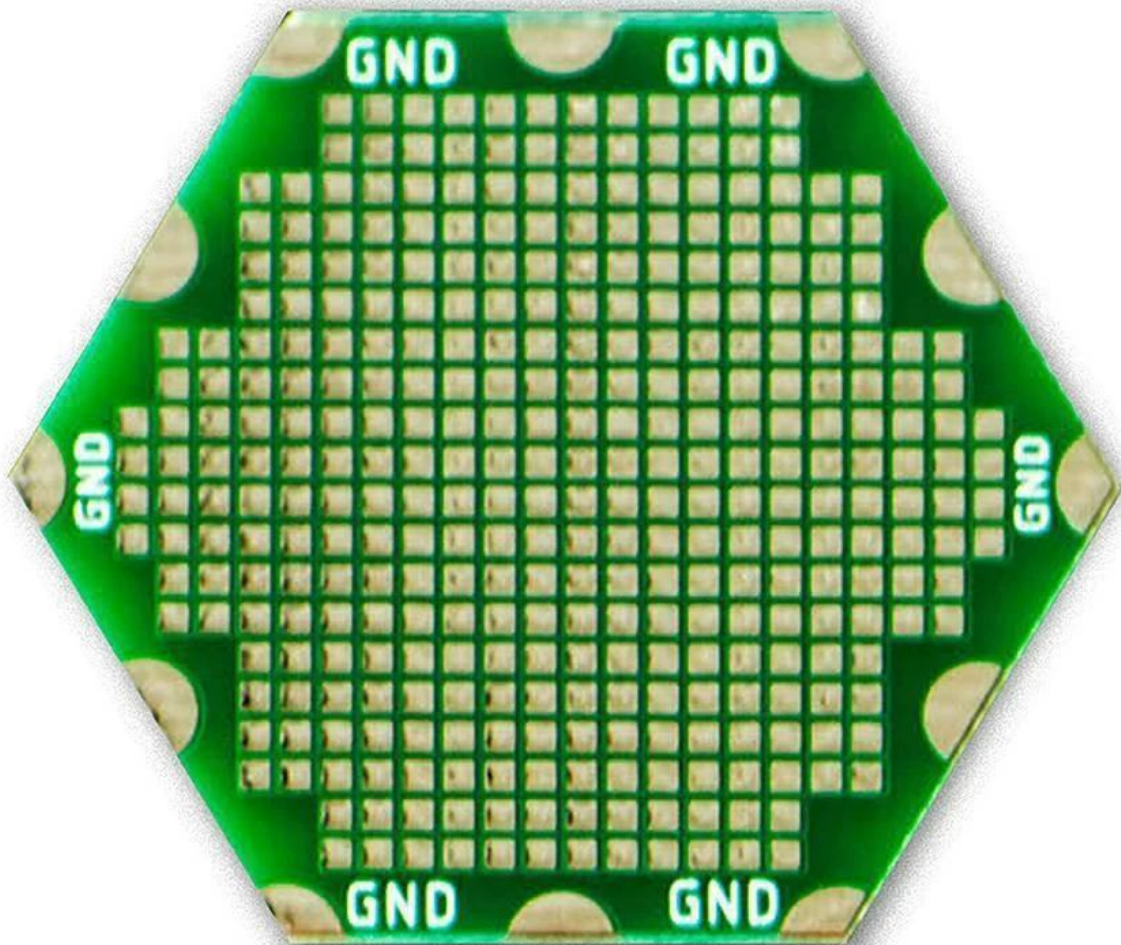
00 0 00 00 :
 00 00

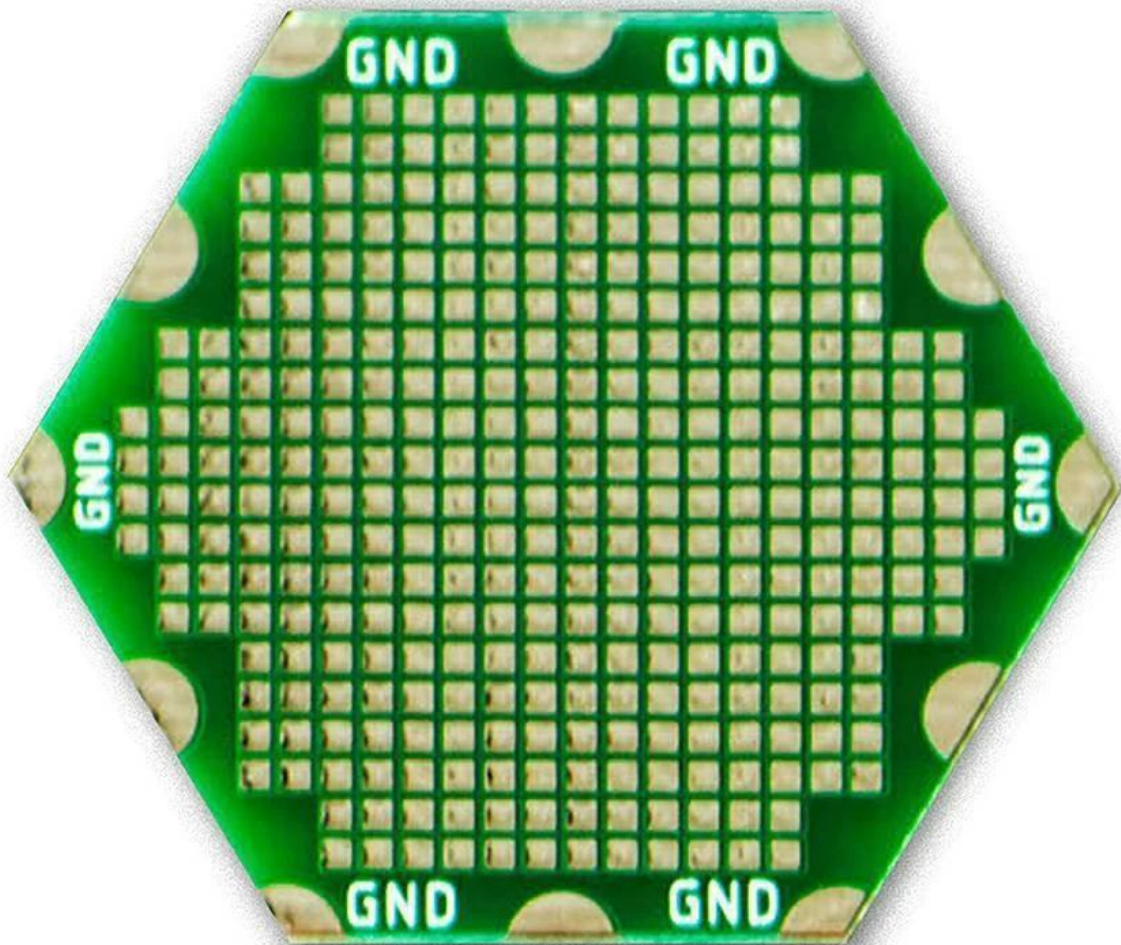
- * 00 000 50mm (1.27mm) 0000 42mil x 42mil SMT 00. 00 00 000 00 00 0000 00 0000
- * 000 00 00 6 0 (+ 3.3V 0 GND 00 00 00 00 00) 000 00 00 0000 00 00 0000 00 0000.
- * 0000 00 0 6 00 00 00. 00 0000 000000. 0000 00 0000 0000 00 00

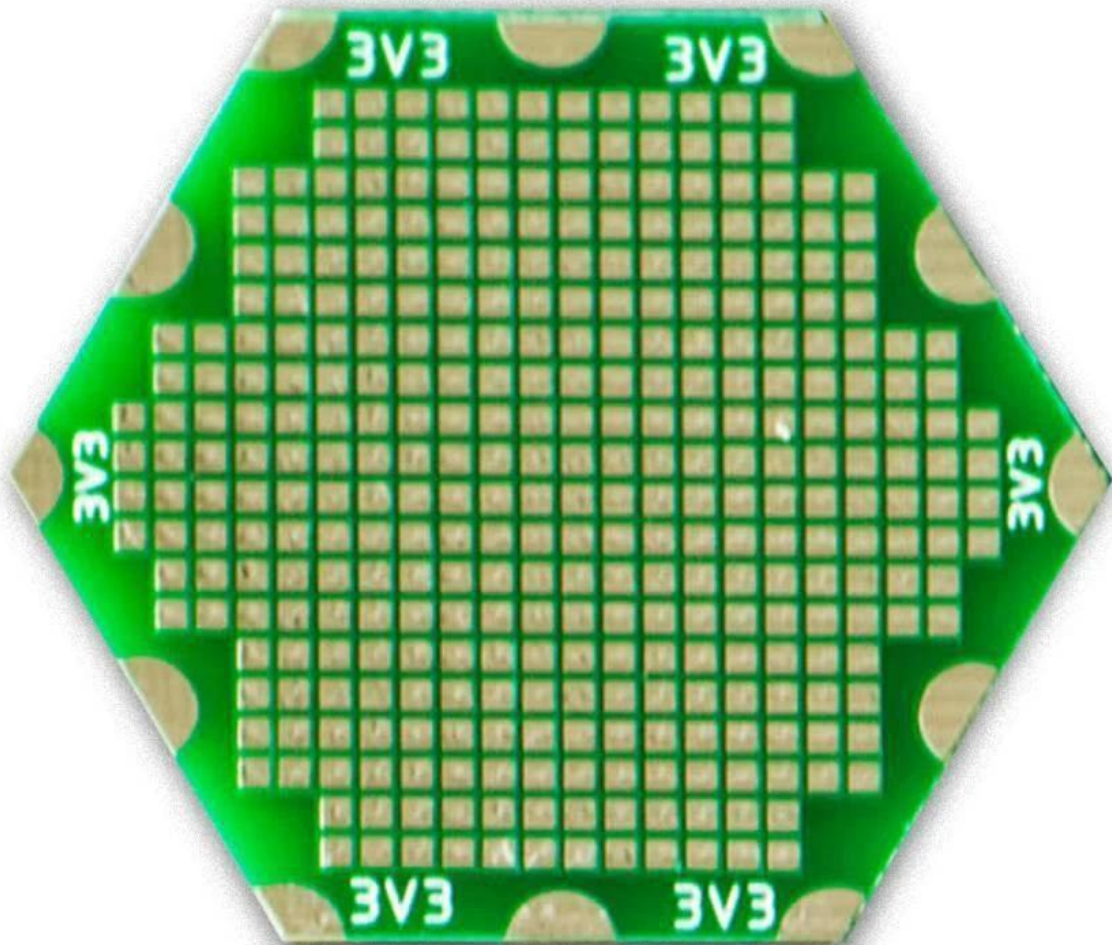
0000 00	
00:	000
00:	30mm 00 000
00:	7.8 00 00 ^ 2
00:	1 0

□□ □□ □□ :	□□ □□
□□ □□ :	ENIG (□) □□ HASL-LF (□□)













Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine

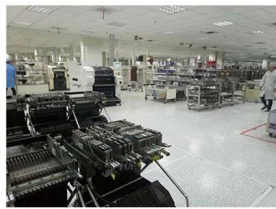


High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT





C I C C INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES
VOEUS BOAD CENTRAL HK

Business Add: 1313, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang
District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System**
Which fulfils the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 ~ February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period


First supervision and audit		Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	---	------------------------------	----------------

The certification implications are under demand to include those production services which shall be covered by the relevant effective administrative provisions and qualification provisions regulated by the state. The effectiveness of this certificate shall be notified by annual surveillance audit of CICC. The certificate shall be valid when used together with the surveillance audit certificate. The initial information of this certificate can be searched at the portal of CICC: www.cicc.com.cn or by the code of inquiry: www.cicc.com.cn






C I C C INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明


诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7
注册地址: 香港中環德輔道中 130-132 號大生銀行大廈 1205 室
经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦 13 楼 1313




建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次发证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经 CICC 黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次年审		第二次年审	粘标处
-------	---	-------	-----

本证书认证范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围。本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效。本证书信息可在国家认监委网站: www.cma.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。




Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

1313.FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ
Date of Sample Received : 22 Mar 2019
Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) , Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP) , and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina
Tina Fan
Approved Signatory



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/terms-and-conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/terms-and-conditions/Electronic-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that unless he/she expressly agrees to the Company's liability at the time of its intended use, the limits of the Company's liability are restricted to the extent of the Company's liability under the applicable law. This document does not constitute an offer of any financial product or service of the Company. Any disclaimer, limitation, waiver or indemnification of the Company's liability or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the samples tested.

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Table with 3 columns: Specimen No., SGS Sample ID, Description. Row 1: SN1, SZX19-005304.001, Green"PCB"

Remarks :

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Table with 5 columns: Test Item(s), Limit, Unit, MDL, QZT. Lists various heavy metals and brominated compounds with their respective limits and units.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at http://www.sgs.com/terms-and-conditions.aspx and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/terms-and-conditions/Electronic-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that unless he/she expressly agrees to the Company's liability at the time of its intended use, the limits of the Company's liability are restricted to the extent of the Company's liability under the applicable law. This document does not constitute an offer of any financial product or service of the Company. Any disclaimer, limitation, waiver or indemnification of the Company's liability or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the samples tested.

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width			SS/ DS/ DSO	Max	Max			Meets UL796	C T	
	Min	Cond	Area		Solder	Flame	Class				
	Min	Edge			Thk			Oper			
mm(in)	mm(in)	mic(mil)	Diam	Limits	Temp	DSR	I				
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘录材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

PCB

PCB	
Layer Count	1-32
Weight	1 / 3oz-12oz
Min. Thickness / Max. Thickness	3.0mil / 3.0mil
Min. Thickness / Max. Thickness	4.0mil / 4.0mil
Aspect Ratio	10 : 1
Min. Drill	0.2mm-5.0mm
Min. Drill (Micro)	635 * 1500mm
Min. Drill (Micro)	4mil
Plated Through Hole	+/- 3mil
Blind / Buried Vias (All)	Yes
Min. Drill (Micro)	Yes
Material	FR-4, FR-4high Tg, Epoxy, Polyimide, Copper, Aluminum
Surface Finish	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion Silver, Electroless Nickel

SMT

PCB Material	FR-4, CEM-1, CEM-3, Epoxy, Polyimide
PCB Size	510x460mm
PCB Size	50x50mm
PCB Thickness	0.5mm-4.5mm
Min. Drill	0.5-4mm
Min. Drill (Micro)	0201
Min. Drill (Micro)	0603
Min. Drill (Micro)	15mm
Min. Drill (Micro)	0.3mm
Min. Drill (Micro)	0.4mm
Min. Drill (Micro)	+/- 0.03mm

PCB

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

O-LEADING

1. O-Leading 100% 100% 100%?

100% 100% 100% 100% 100%.

1.1 100% ISO 9001 : 2008 100% 100% 100%.

1.2 100% 100% 100% 100% 100%

1.3 100% 100% 100% 100% : 100% 100%, X-ray 100%, AOI (Automated Optical Inspector) 100% ICT (in-circuit testing).

1.4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5. 100% 100% 100%

2. O-Leading 100% 100% 100%?

100% 100% 100% (100% : 100%, 100% 100%) 100% 100%, 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 31% 100%. 100% 100% 100%.

100% O-Leading 100% 100% 100%. 100% 100%, 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

3. O-Leading 100% 100% 100% 100%?

100% FR4, 100% TG 100% 100% 100%, Rogers, Arlon, Telfon, 100% / 100% 100%, PI 100%

4. PCB 及 PCBA 的製造過程是什麼?

- 4.1 如何制定 BOM (Bill of Materials) : 物料清單, 物料清單表 及 物料清單表.
- 4.2 PCB Gerber 文件.
- 4.3 PCB 的製造及 PCBA 的製造.
- 4.4 物料清單.
- 4.5 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表.

5. 如何 PCB 的製造過程是什麼?

物料清單 → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 AOI → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 → PTH → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 → 物料清單表 → E / T → 物料清單表.

6. HDI 的製造過程是什麼?

物料清單表 物料清單表 : 物料清單表, 物料清單表, VCP 物料清單表, 物料清單表, LDI 物料清單表
物料清單表 物料清單表 物料清單表, 物料清單表 物料清單表 Mitsubishi Hitachi 物料清單表, LDI 物料清單表 Screen (Japan) 物料清單表, 物料清單表 Hitachi 物料清單表 物料清單表, 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表.

7. O-lead 的製造過程是什麼?

O-lead 物料清單表 ENIG, OSP, LF-HASL, 物料清單表 (物料清單表 / 物料清單表), 物料清單表, 物料清單表, 物料清單表 物料清單表, 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表. HDI 物料清單表 物料清單表 物料清單表 OSP, ENIG, OSP + ENIG, BGA PAD 物料清單表 0.3 mm 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 OSP OSP + ENIG 物料清單表 物料清單表 物料清單表.

8. FPC 的製造過程是什麼? O-Leading SMT 的製造過程是什麼?

O-Leading 物料清單表 物料清單表 8 物料清單表 FPC 物料清單表 物料清單表, 物料清單表 物料清單表 2000mm * 240mm 物料清單表 物料清單表. 物料清單表 "Flex Capability" 物料清單表 物料清單表.
物料清單表 物料清單表 SMT 物料清單表 物料清單表 物料清單表.

9. PCB 的製造過程是什麼?

- 物料清單表;
- 物料清單表;
- 物料清單表;
- 物料清單表 物料清單表;
- PCB 物料清單表;
- 物料清單表;
- 物料清單表 物料清單表.

10. PCB, PWB 及 FPC 的製造過程是什麼?

PCB 物料清單表 物料清單表 物料清單表.
PWB 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表.
FPC Flexible Printed Board 物料清單表 物料清單表.

11. PCB 的製造過程是什麼?

PCB 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表.
物料清單表 Tg 物料清單表 物料清單表 物料清單表.
物料清單表 CTE 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表;
物料清單表 物料清單表 : 物料清單表 PCB 物料清單表 50 物料清單表 250 °C 物料清單表.
物料清單表 物料清單表; 物料清單表 物料清單表 物料清單表 / 物料清單表 物料清單表 PCB 物料清單表. 物料清單表 PCB 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表; 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表.

12. O-leading 的製造過程是什麼?

O-leading 物料清單表 物料清單表 PCB FPC PCB 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表. 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表 物料清單表.

13. 物料清單表 物料清單表 物料清單表?

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□, SI6000 soft □ POLAR INSTRUMENTS□ CITS 500s □□□ □□□□ □□□□□.
□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□.